

フリップチップ実装試作・評価受託

新規フリップチップボンダーを導入しました!

- ▶ 対応チップサイズ：0.4mm□～30mm□
- ▶ 対応基板サイズ：最大300mm□
→ 8 inchおよび12inchウェハサイズにも対応
- ▶ 搭載精度：±2.0 μm



- リジット基板からSiインターポーザ、FPC基板へのフリップチップ実装を一貫サポート
- 熱圧着接合、超音波接合のいずれの工法にも対応
- 試作時の立会いや材料評価も承っています

フリップチップサービスフロー

ご仕様
お打合せ

部材準備

フリップチップ
ボンディング

フラックス
洗浄

アンダーフィル
塗布

X線・SAT
反り測定等
各種評価

納品

2.5D/3D高密度実装受託サービス

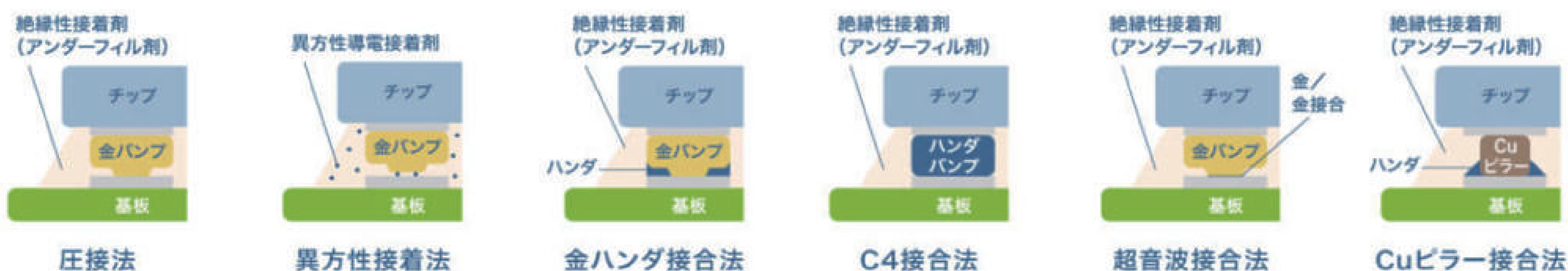
2.5D/3D高密度実装に関する部材調達～組立～評価までトータルサポート致します

フリップチップ実装

- 多様なFC工法に対応可能
お客様のアプリケーションや目的にあわせた工法を提案致します。
- 新規開発材料を用いた評価用サンプル組立にも対応
- 少量からの実装対応また評価用TEGチップおよび基板の準備も可能です
- アンダーフィル材の塗布 及びモールド封止も弊社内工程で対応致します

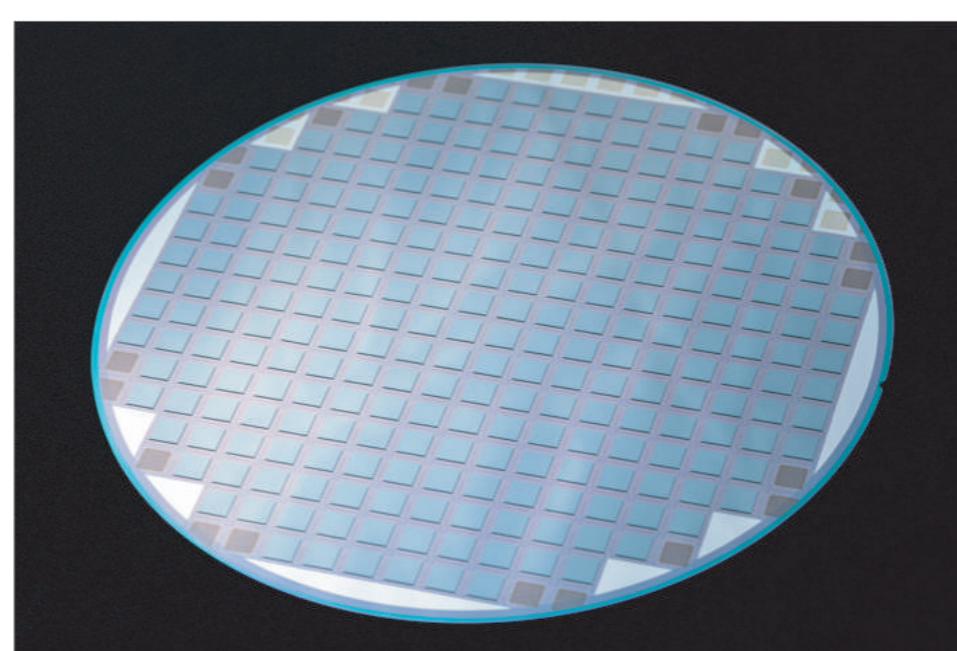
★新規フリップチップボンダー導入

ラージエリア(最大12inch)、微小チップ(最小0.4mm \square)、高精度 (搭載精度 $\pm 1.0\mu\text{m}$)



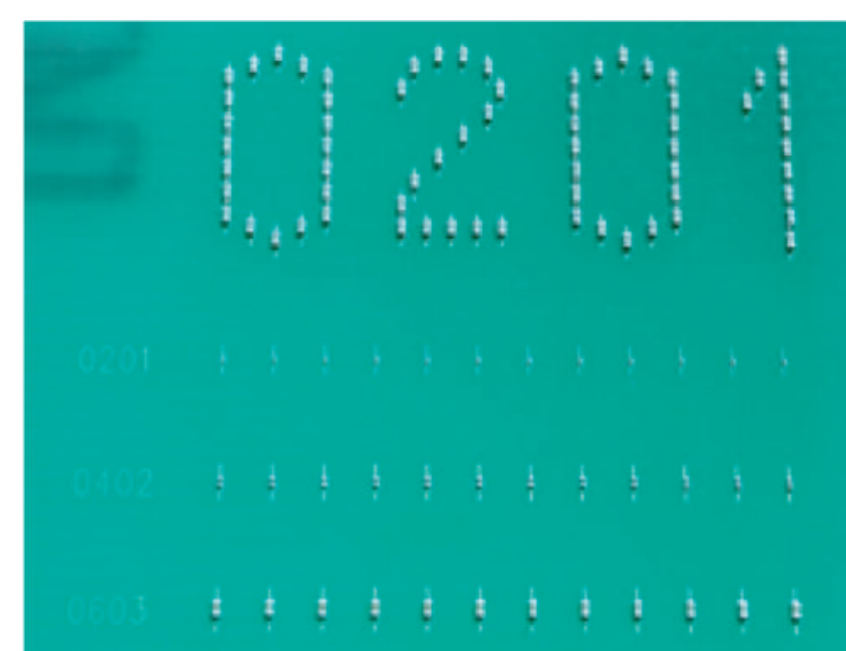
ウェハレベルボンディング

- 8インチ、12インチウェハサイズへのFC実装可能

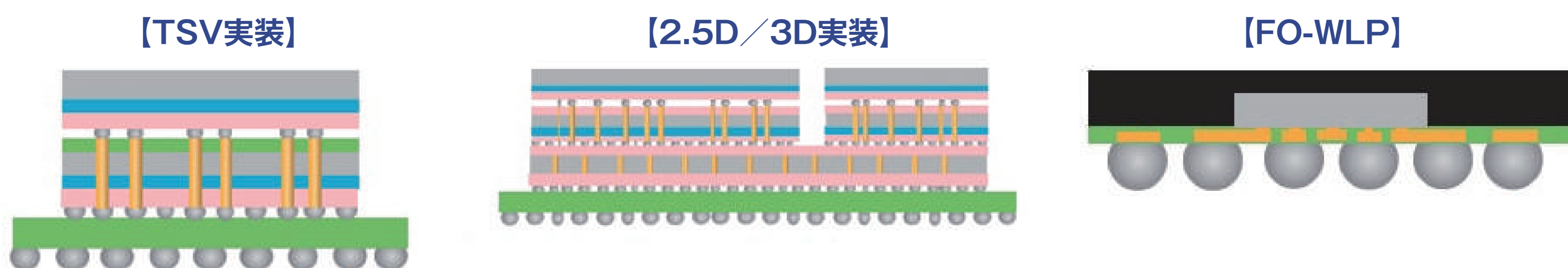


部品半田実装

- 0201サイズのLCR実装可能



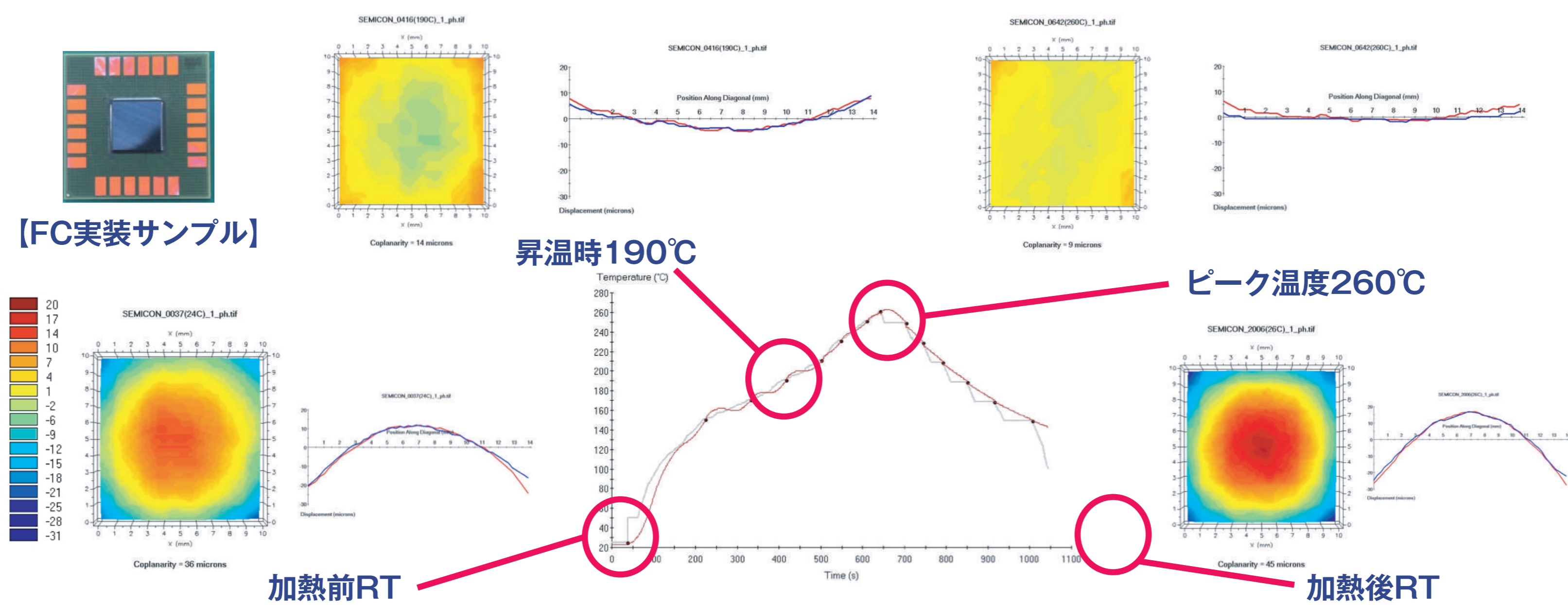
チップレット対応実装例



2.5D/3D高密度実装 評価受託

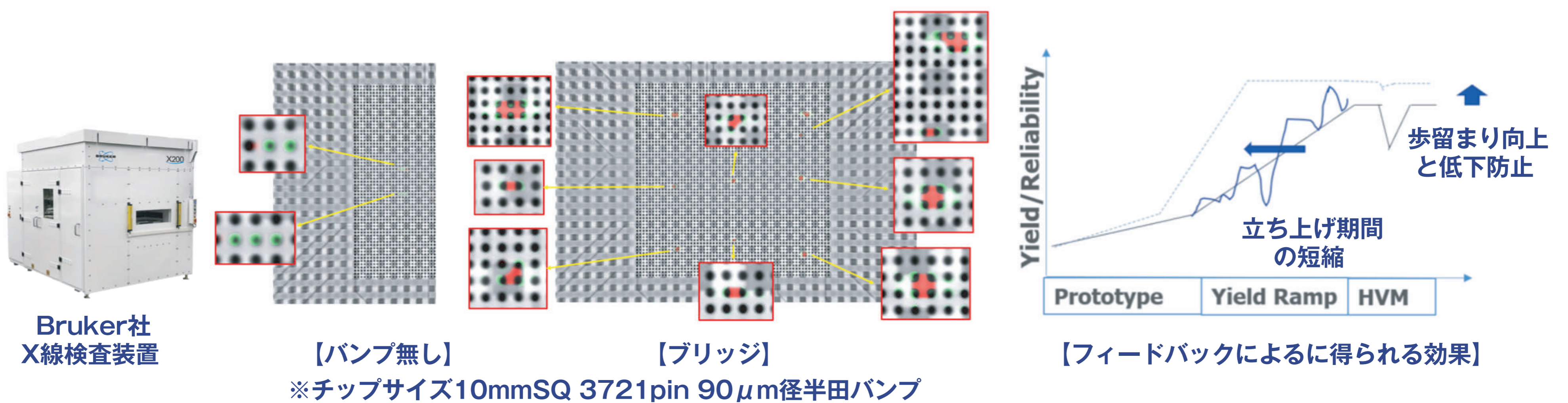
実装実験、材料評価、非破壊検査、不良解析、信頼性試験等を用い目的に合わせた評価・検査・解析を提案いたします

加熱時非接触反り測定 =リフロー想定例=



非破壊自動検査 =90μm径FCバンプX線検査例=

●2D-X線撮影&不良モード別自動検出 → 非破壊全数検査の実現



不良解析 =CT-X線 SAT 断面観察例=

